

欣銓科技股份有限公司

上櫃公司精選法說會

報告人：張季明 總經理

July 9, 2008

重點摘要

- 2008年上半年營收自結數為新台幣2,028,288仟元，合併營收自結數為新台幣2,134,496仟元，較2007年同期成長29.8%及33.8%，為台灣半導體製造鏈中成長率最強勁的公司之一
- 2008年第2季營收自結數為新台幣979,230仟元，合併營收自結數為新台幣1,026,502仟元，較2008年第一季營收及合併營收分別小幅衰退6.7%及7.4%，符合預期
- 2008年6月中旬，欣銓科技董事會通過原任總經理秦曉隆轉任總工程師暨技術總監，原任執行副總升任總經理
- 對2008年第3季業績展望審慎樂觀，可望有3%~8%之成長(合併營收介於新台幣1,057,297元~1,108,622元之間)

H1/2008營收狀況

欣銓(臺灣)

單位：新台幣仟元

	營收	前一期營收	QoQ HoH	去年同期營收	YoY
1Q'08	1,049,058	1,039,833	0.9%	731,347	43.4%
2Q'08(註)	979,230	1,049,058	(6.7%)	831,513	17.8%
H1'08(註)	2,028,288	2,088,512	(2.9%)	1,562,860	29.8%

欣銓(合併)

單位：新台幣仟元

	營收	前一期營收	QoQ HoH	去年同期營收	YoY
1Q'08	1,107,994	1,108,570	(0.1%)	736,785	50.4%
2Q'08 (註)	1,026,502	1,107,994	(7.4%)	858,902	19.5%
H1'08 (註)	2,134,496	2,216,089	(3.7%)	1,595,687	33.8%

註：2Q'08及H1'08營收係自結數，尚未經會計師查核簽證

半導體製造鏈相關公司參考數據

新台幣仟元；
EPS、收盤價及現金股利：元

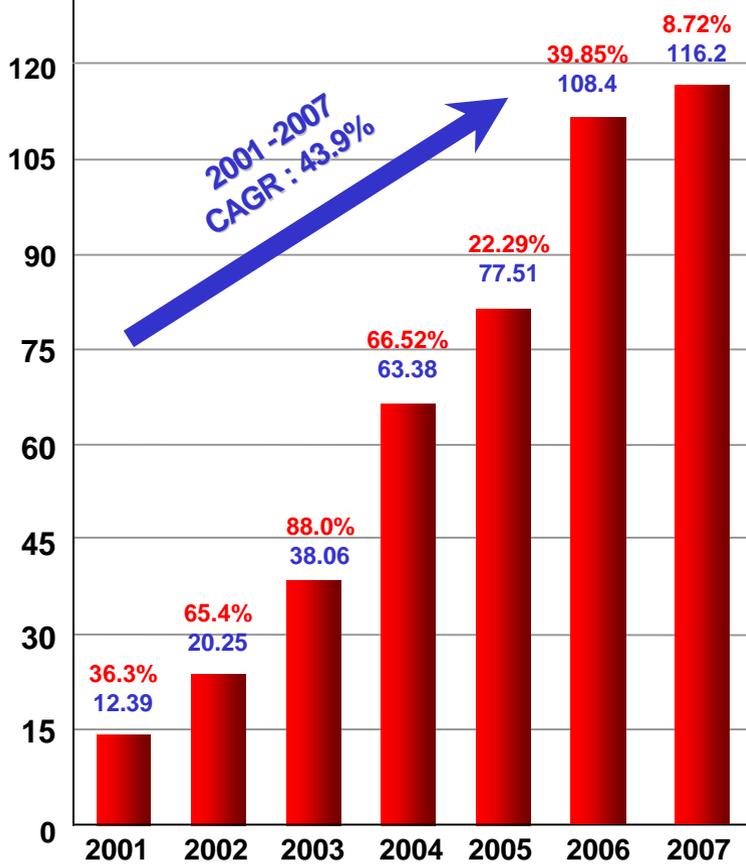
	2007年			2008年1~5月		1Q/2008	2008/6/30 收盤價	現金 股利	現金 殖利率
	Revenue	ROE	EPS	Revenue	YoY	EPS			
晶圓代工									
A	322,630,596	22.0%	4.14	146,144,175	28.5%	1.10	65.00	3.00	4.6%
B	113,311,298	6.2%	1.09	41,130,795	4.5%	0.02	16.10	0.75	4.7%
C	15,973,012	19.3%	2.55	7,561,112	25.2%	0.45	22.25	1.70	7.6%
凸塊									
D	5,858,234	19.0%	3.61	2,572,953	22.9%	0.62	25.00	2.28927	9.2%
成品封裝/測試									
E	101,163,069	16.8%	2.34	41,722,253	14.4%	0.44	27.30	1.71	6.3%
F	66,177,329	26.5%	5.80	25,246,142	6.3%	0.58	44.75	4.50	10.1%
G	24,658,202	39.4%	11.08	12,528,169	36.7%	2.81	106.50	4.00	3.8%
H	8,871,751	26.5%	5.07	3,747,118	15.3%	0.78	35.50	3.00	8.5%
晶圓測試									
I	14,485,591	8.5%	1.59	5,909,481	17.6%	0.25	13.20	0.60	4.5%
J	3,909,505	12.4%	2.12	1,555,864	12.9%	0.15	14.55	1.08	7.4%
K	2,026,775	8.7%	1.22	773,956	(2.4%)	0.23	10.90	1.00	9.2%
欣銓	3,811,776	16.6%	2.62	1,786,639	38.3%	0.83	19.65	1.61	8.2%

營收成長

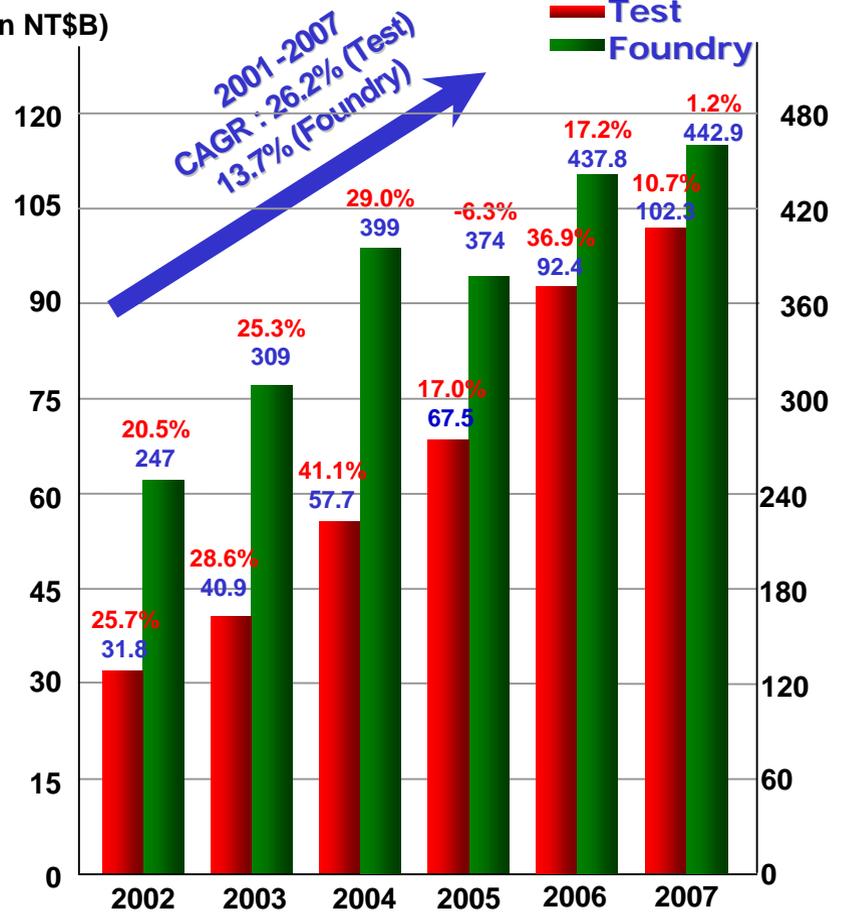
欣銓科技

臺灣半導體產業

(in US\$M)



(in NT\$B)



Data Source: IEK 2008 Feb.

良好的財務比率 (臺灣)

年度	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
流動性比率							
流動比率	138%	172%	173%	226%	177%	218%	201%
速動比率	134%	165%	168%	215%	167%	206%	195%
資產管理比率							
固定資產週轉率	0.19	0.26	0.43	0.60	0.57	0.68	0.65
總資產週轉率	0.14	0.21	0.33	0.43	0.40	0.46	0.42
負債管理比率							
負債比率	41.2%	51.0%	46.5%	31.3%	35.9%	29.6%	31.6%
利息保障倍數	-	0.34	3.90	10.08	14.30	19.19	15.96
獲利性比率							
毛利率	-24.2%	10.7%	33.1%	45.3%	40.9%	42.2%	39.0%
總資產報酬率	-5.9%	2.7%	11.4%	17.3%	13.7%	15.0%	12.3%
股東權益報酬率	-11.0%	0.3%	17.6%	25.2%	19.3%	21.1%	16.6%
每股盈餘	-1.06	0.03	1.78	3.00	2.62	3.05	2.62

競爭優勢

- 與客戶群中的晶圓製造工程師、產品測試工程師及產品設計工程師有相同的語言
- 欣銓的品質系統能夠迅速處理大量的測試資訊，滿足客戶的質與量之需求
- 欣銓透過web enabled WIP/EDAS等IT系統，能夠提供即時且透明的訊息回饋
- 欣銓擁有服務國際級一流大廠的系統與經驗
- 欣銓擁有臺灣最大的12吋晶圓測試產線，足以服務世界級的客戶
- 欣銓在新加坡已建置好營運中心能夠提供客戶群更寬廣及彈性的服務

優質測試品質的領導者

- 榮獲美商德州儀器公司(Texas Instruments) 2003年及2005年全球優異供應商獎(Supplier Excellence Award)
- 榮獲美商新帝公司(SanDisk)2007年傑出商務夥伴獎(Outstanding Business Partner Award)
- 2008年第一季榮獲ISO27001資訊安全管理系統(Information Security Management System)認證

系統封裝 / 裸晶測試技術的領先廠商

追求摩爾定律，系統封裝正是趨勢

- 在趨向高度整合、SiP測試需求、異質多功能整合的無線元件市場，KGD (Known-Good-Die) 測試的需求與重要性日益增加
- KGD 測試是目前主要的解決方案，因為沒有其他方式可以滿足在SiP 形式下所有的測試需要

欣銓在KGD測試技術的貢獻

- 可靠性及品質篩選流程
 - 晶圓級預燒
 - 應用統計技術的品質篩選程序(outlier process) 以及特定樣式異常的篩選
- 良率改善製程
 - 雷射修補
 - 類比信號微調
 - 註記編碼
- 高整合測試流程
 - 作業管制自動化IT系統
- 節省成本方案
 - 高並測數
- 高速測試
 - 可測試設計之結構測試
- 低功率及 & 行動性
 - 低溫及漏電流測試
- 晶圓製程線距微縮
 - 12吋晶圓針測
 - 鐳墊微距產品 (Fine Pad Pitch) 針測
 - 微距融絲 (Fine Link Pitch) 雷射修補
 - Low-k 銅製程鐳墊針測

在新興的價值鏈上扮演處理中心的角色

- 進入奈米時代，欣銓在後段流程中建立一個“後製程” (Post-Process)
- 整合設計、製造、測試之所有數據，用以篩選 IC
- 經由資訊高速公路，提供最廣泛的測試數據
- 在有價值的數據鏈上扮演“處理中心”的角色

